

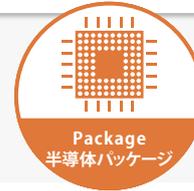
## For SMD module low warpage liquid encapsulant SMDモジュール用 低反り液状封止材



### Applications 用途

Communication module (MAP, COB) for mobile devices such as notebook PC, digital camera, mobile phone, smartphone, tablet PC.

ノート PC、デジカメ、携帯電話、スマートフォン、タブレット PC 用通信モジュール (MAP、COB)



Enhances process reliability by warpage control and high adhesion (Low warpage of ultrathin module is achieved). Solder flash during mounting reflow has been reduced, resulting in greatly decreasing the defect ratio. Large encapsulation area.

実装リフロー時の半田フラッシュを抑制し、不良率を大幅低減します。超薄型モジュールの低反り化を実現。大面積封止が可能。

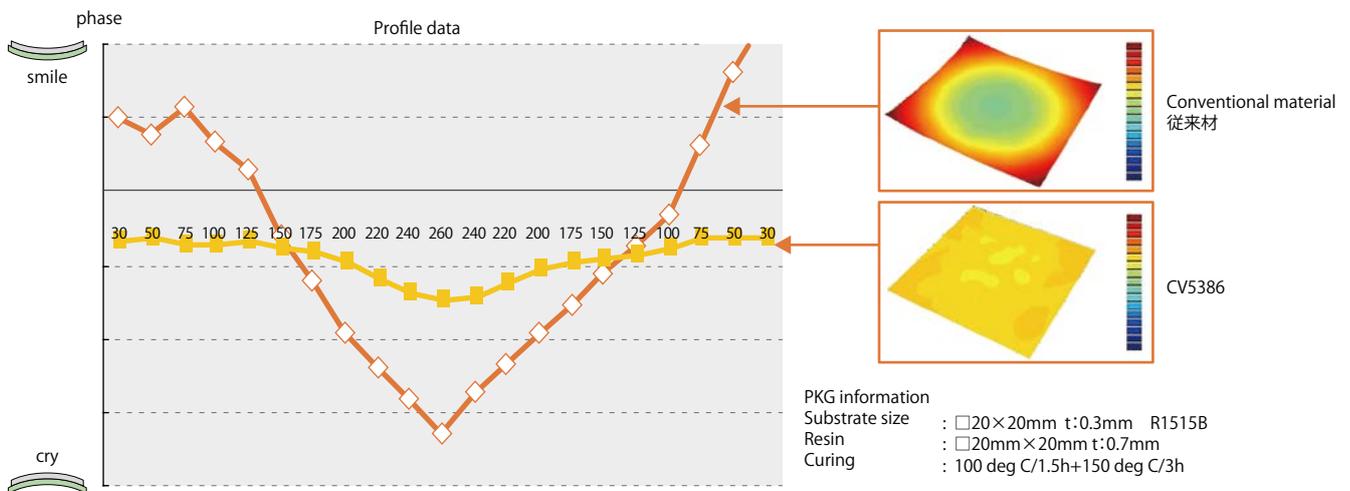
Warpage control  
反りコントロール

High adhesion  
高密着

Reduced solder flash  
半田フラッシュ抑制

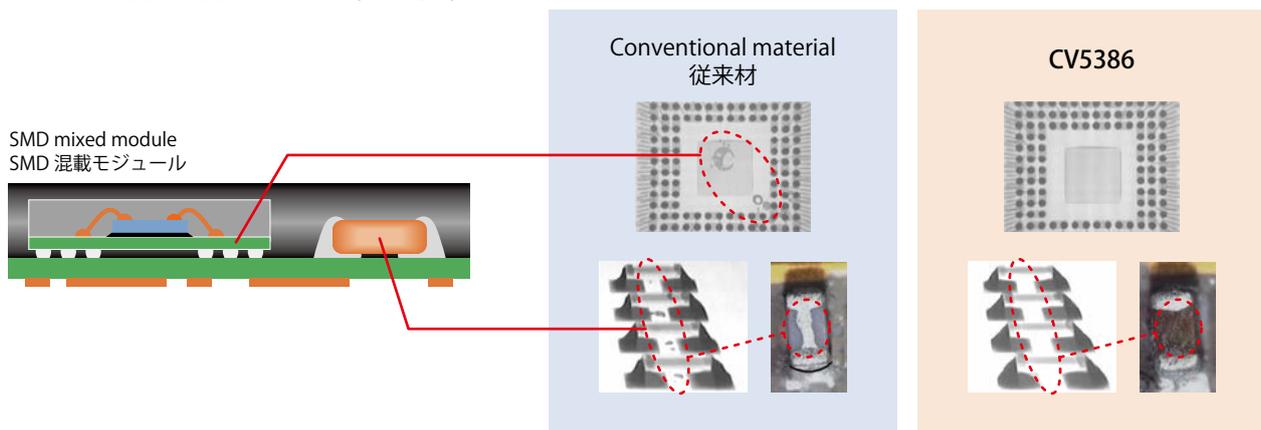
### Warpage behavior : Shadow moire analysis

反り挙動: シャドウモアレ解析



### Solder flash after mounting reflow has been reduced (X-ray observation)

実装リフロー後の半田フラッシュ (X線観察)



The above data are typical values and not guaranteed values. 上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。